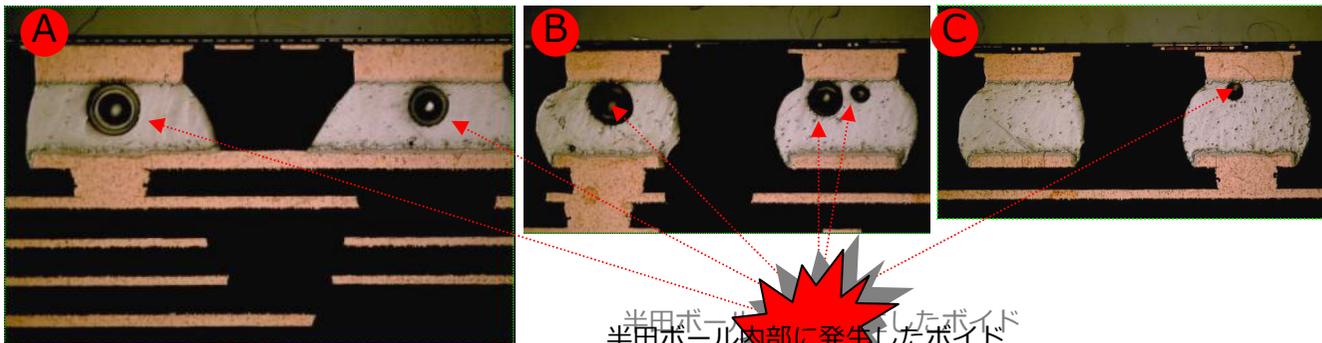
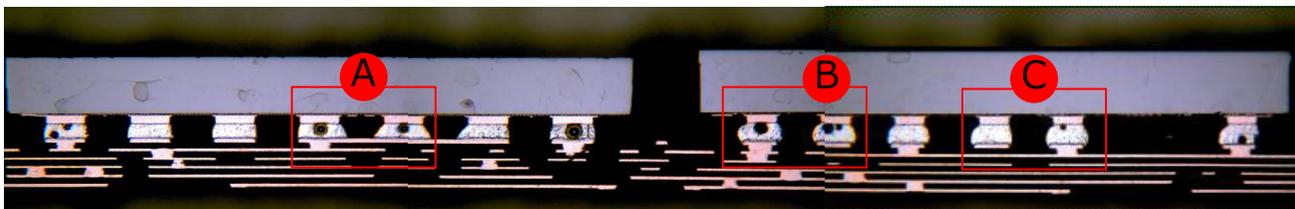


半田ボールの断面研磨 - 2

① モジュール基板と搭載電子部品接続部のボール断面



- 断面研磨を行うことで、構造的な色々の情報が見えてきます。
下記 P K G の半田ボール部には多くの内部ボイド (●) が発見されました。